SiO2を含有するスーパーセンダスト(I)系薄膜の

結晶構造と軟磁気特性

日大生産工(院)	王	鋒	
日大生産工	新妻	清純・移川	欣男

<u>1.はじめに</u>

近年,磁性材料を応用した HDD などのスト レージデバイスは大容量化が進んでおり,垂 直記録方式における高密度記録,高速応答性 を有する材料の開発は望まれている。特に, 書き込み用薄膜ヘッド用材料においては,高 飽和磁束密度,低磁歪,低保磁力,高電気抵抗 率であり,高周波帯域での損失などが少なく, 高い実効透磁率を有することが求められてい る。

6.0wt%Si-4.0wt%Al-3.2wt%Ni-bal.Feの 組 成を有するスーパーセンダスト(I)[SS(I)] 合金は優れた軟磁気特性を有しているため¹⁾, 書き込みヘッドに適した磁性材料であると言 える。金属磁性粒子と非磁性絶縁体からなる ナノグラニュラー構造磁性薄膜は,粒径がナ ノスケールの金属磁性粒子と,それを取り囲 む非磁性絶縁体の粒界からなる構造を有する ため,高周波における軟磁気特性,トンネル 型磁気抵抗効果(TMR)などを有することが報 告されている²⁾。

そこで,本研究では,RFマグネトロンスパ ッタリング法を用いて,アルゴンガス雰囲気 中で,SiO₂を添加することによりナノグラニ ュラー構造を有するSS(I)系薄膜の作製を試 み,SS(I)系薄膜の軟磁気特性に及ぼす結晶構 造等の影響について検討を行った。

<u>2.実験方法</u>

SiO₂を含有するSS(I)系薄膜の作製にはRF マグネトロンスパッタ装置を用いた。装置の 概略をFig.1 に示す。



Fig.1 Schematic diagram of RF magnetron sputtering apparatus.

真空チャンバー内にターゲットである陰極 とそれに対向するように基板ホルダの陽極が 設置され,高周波プラズマ放電とターゲット 下部に設置された磁石による印加磁場により 基板上に薄膜が堆積するようになっている³⁾⁴⁾。 SS(1)系薄膜試料を作製する際には 6.7wt%Si-4.5wt%Al-3.2wt%Ni-bal.Feの組成 を有する合金ターゲットを用いた。薄膜に Si0₂を添加するため,Si0₂チップをターゲット上 で中心より25mmの円周上に等間隔に配置さ せた⁵⁾。その後,チャンバー内を4.0×10⁻⁴Pa以 下まで高真空排気し,純Arガスを用いてチャ ンバー内の圧力を4.0Paとし,投入電力が 400Wの条件で,放電させた。Si0₂チップと

Crystal Structure and Soft Magnetic Properties of Super Sendust (1) System Thin Films Containing SiO₂ Feng WANG,Kiyozumi NIIZUMA and Yoshio UTSUSHIKAWA ターゲットの面積比を 3.14%, 3.98%, 4.72%, 6.28%, 7.08%, および7.86%と変 化させ, 膜厚を1µmとなるように成膜した。

なお,基板には磁気特性ならびに結晶構造 解析にはソーダライムガラス基板を,定性, 定量分析には無酸素銅基板をそれぞれ用い, 基板加熱は行わなかった。作製したSS(1)系薄 膜試料の飽和磁化Msならびに保磁力Hcの測定 には振動試料型磁力計(VSM),結晶磁気異方性 の測定にはバランシングコイル型トルク計, 比実効透磁率µ,の測定にはフェライトヨー ク法,組成分析ならびに定量分析には電子線 マイクロアナライザ(EPMA),結晶構造解析に はCu-K を線源とするX線回折装置(XRD),表 面観察には原子間力顕微鏡(AFM),膜厚の測定 には繰り返し反射干渉計,重量測定にはマイ クロ天秤をそれぞれ用いた。

3.実験結果および考察

<u>3.1 EPMAによる定量分析</u>

種々のSiO₂チップとターゲットの面積比で
 作製されたSS(I)系薄膜のEPMAによる定量分
 析の結果をTable1 に示す。

Table1 Chemical composition of SS(I)system thin films on area ratio of SiO_2 chip for target.

SiO ₂ area	Chemical composition					
ratio [%]	Fe	Si	AI	Ni	0	
3.14	85.40	5.32	2.65	3.17	3.46	
3.98	85.37	5.14	2.46	3.21	3.82	
4.72	83.45	5.48	2.80	2.97	5.30	
6.28	81.84	6.53	3.06	3.00	5.57	
7.08	84.04	5.89	2.69	2.74	4.66	
7.86	80.88	5.74	2.97	2.74	7.67	

表より, Fe, Si, AI, Niの組成比はSiO₂の面積 比の増加に伴って, 顕著な変化が認められな かった。Siの組成比はSS(1)合金ターゲットの 組成比より低下したのは,Siのスパッタ率が 低いためと考えられる。Oの組成比は,Si02の 面積比 3.98~7.08%においては顕著な変化 が認められなかったが,Si02の面積比 3.14% の 3.46wt%と比べると,Si02の面積比 7.86% では,7.66wt%と大量にOがSS(1)系薄膜に混 入していることが認められた。

<u>3.2 VSMによる磁気特性</u>

種々のSiO₂チップとターゲットの面積比で 作製されたSS(I)系薄膜のVSMによる磁気特性 をFig.2 に示す。





図より, 飽和磁化Msは, Si0₂の面積比が 3.14%の時, 最大値Ms=2.52×10⁻⁴Wb・m/kgを 示し, Si0₂の面積比が 3.98%の時, 最小値 Ms=2.22×10⁻⁴Wb・m/kgを示した。保磁力 HcはSi0₂の面積比が 3.14%の時, 最大値 Hc=0.791kA/mを示し, Si0₂の面積比が 7.86% の時, 最小値Hc=0.511kA/mを示した。Si0₂の 面積比が 3.98~7.08%においては, 飽和磁化 Msと保磁力Hcと共にSi0₂の面積比の増加に依 存せず, 顕著な変化が認められなかった。

<u>3.3比実効透磁率 μrならびに垂直磁気異方性</u> 値K <u>のSi0の面積比依存性</u>

種々のSiO₂チップとターゲットの面積比で 作製されたSS(I)系薄膜について,容易軸で周 波数f=10MHzにおける比実効透磁率 µ,ならび に

垂直磁気異方性値K のSiO2の

面積比依存性

をFig.3 に

示す。





図より, 比実効透磁率µ, はSi02の面積比が 7.86%の時, 最大値µ,=313 を示し, Si02の面 積比が3.14%の時,最小値µ,=95.9を示した。 また, 垂直磁気異方性値K は, Si02の面積 比が7.08%の時,最大値K =18.76×10⁴J/m³を示 し, Si02の面積比が4.72%の時,最小値K =3.55×10⁴J/m³を示した。Si02の面積比の増加 に伴って, 比実効透磁率µ,は増加する傾向が 認められたが, 垂直磁気異方性値K は顕著な 変化が認められなかった。

3.4 X線回折図形による結晶構造解析

種々のSiO₂チップとターゲットの面積比で 作製されたSS(I)系薄膜のX線回折図形を Fig.4に示す。



Fig.4 X-ray diffraction patterns of SS(I) system thin films.

図より,Si0₂の面積比が 3.14~7.08%にお いては,2 =44.86°付近に(110),2 =65.55° 付近に(200),2 =82.86°付近に(211), 2 =99.62°付近に(220)からの回折線が認め られ,ターゲットと同じ体心立方晶であるこ とが明らかとなった。

また _SiO₂の面積比が 7.86%の時において, 顕著な回折線が認められなかった。これは, Oの組成比が高かったため結晶性が悪くなっ たと考えられる。

<u>3.5 AFMによる表面観察</u>

種々のSiO₂チップとターゲットの面積比で 作製されたSS(I)系薄膜のAFMによる表面観察 をFig.5 に示す。



Fig.5 AFM image for SS(I)system thin films.

図より,薄膜表面の粗さはSiO2の面積比が 3.14%,6.28%ならびに7.08%において,大きく なっているが,SiO2の面積比の増加に伴う顕 著な変化は認められなかった。

<u>3.6 平均面粗さRaならびにX線的結晶粒径t値</u> のSi0₂の面積比依存性

種々のSiO₂チップとターゲットの面積比で 作製されたSS(I)系薄膜の平均面粗さRaなら びにX線的結晶粒径t値のSiO₂の面積比依存性 をFig.6に示す。



Fig.6 Dependence of average of surface roughness Ra and X-ray average grain size $t_{(110)}$ for SS(I) system thin films on area ratio of SiO₂ chip for target.

図より,平均面粗さRaはSiO2の面積比が 3.14%の時,最大値Ra=7.13nmを示し,SiO2の 面積比が3.98%の時,最小値Ra=5.51nmを示し た。平均面粗さRaはSiO2の面積比の増加に伴 って顕著な変化が認められなかった。また, 結晶粒径t値は,SiO2の面積比が3.14%の時, 最大値t=29.0nmを示しSiO2の面積比が7.86% の時,最小値t=11.7nmを示した。SiO2の面積 比が 3.14~7.08%においてほぼ一定であっ たが,7.86%で明らかに小さくなったことが認 められた。これはOの組成比が高かったため, 微細結晶化されたためと考えられる。

<u>4.まとめ</u>

RFマグネトロンスパッタリング法によ リ,Arガス雰囲気中でSi0₂チップとターゲ ットの面積比を3.14%,3.98%,4.72%, 6.28%,7.08%,および7.86%と変化させ, 作製したSS(I)系薄膜の軟磁気特性に及 ぼす結晶構造等の影響について検討を行 った。本実験の結果をまとめると次の通 りである。

 1) 定量分析においては、Si02の面積比の 増加に伴って、Siの組成比は顕著な変化 は認められなかったが、Oの組成比は Si02の面積比が 7.86%で高くなることが 認められた。

2) SiO₂の面積比が 3.14%の時, 飽和磁化 Msは,最大値Ms=2.52×10⁻⁴Wb・m/kgを示 し,SiO₂の面積比が 4.72%の時, 垂直磁気 異方性値K は最小値K =3.55×10⁴J/m³を 示した。

3) 平均面粗さRaはSiO₂の面積比が 3.98% の時,最小値Ra=5.51nmを示し,SiO₂の面積 比の増加に伴う顕著な変化は認められな かった。

4) 結晶粒径t値は,Si0₂の面積比が7.86% の時,最小値t=11.7nmを示し,Oの組成比 との相関が認められた。

5) Arガス雰囲気中で,SiO₂チップとター ゲットの面積比を変化させ作製した SS(I)系薄膜では,SiO₂の面積比が 7.86% の時,飽和磁化Msは 2.39 × 10⁻⁴ Wb・m/kg, 保磁力Hcは最小値 0.511kA/m,比実効透磁 率 μ,は,最大値 μ,=313 を示し,最良の 軟磁気特性と言える。

参考文献

- 山本達治,移川欣男;日本金属学会 誌,VOI.40,NO.10,975(1975)
- 2) 田中陽一郎,彦坂和志,市原勝太郎;日本 応用磁気学会会誌,VOI.22, NO.10,(1998)
- 3) 金原粲:「スパッタリング現象」東京大学 出版(1984)
- 近藤 剛,新妻清純,移川欣男:「ナノ結 晶を有する Fe-Si-AI-Ni 系薄膜の軟磁気 特性」電気学会誌,120(2000),174-179
- 5) 有村唯史,新妻清純,移川欣男:「RF 方式に よる Fe-Si-AI-Ni 系薄膜の微細化と軟磁 気特性に関する研究」(平成 13 年度修士 論文)